

Investor Relations

No.1

will make the semiconductor industry prosper
TechWing Company

2018

주식회사 테크윙

Disclaimer



본 자료에 포함된 (주)테크윙(이하 “회사”)의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하며 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 용어를 사용 하였습니다.

위 “예측정보”는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수도 있습니다.

또한 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다. 본 자료에 열거한 주요한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없으며, 회사는 새로운 정보 및 미래의 사건 등으로 그 사실을 공지할 의무가 없습니다.

당사는 본 IR 자료에 표기된 사항 중 공정공시에 해당하는 사항은 IR행사 당일 공정공시를 통하여 공개하오니 공정공시를 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 미래의 경영목표와 같이 공정공시에 해당되지 않는 경우는 당사의 경영목표일 뿐 예측 및 전망자료가 아님을 다시 한번 강조하오니 투자판단에 유의하여 주십시오. 전망실적에 대하여는 “전망”, 미래 경영목표에 관하여는 “목표”로 구분하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

will make the semiconductor
industry prosper

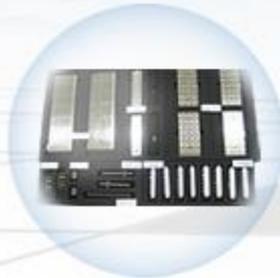
Contents

Chapter 1. 회사소개

Chapter 2. 사업소개

Chapter 3. Financial Highlight

Chapter 1. 회사소개



1. 회사 개요



일반 개요

회사명	주식회사 테크윙	
대표이사	나 윤 성	
설립일	2002년 7월 18일	
자본금	94억원(현재)	
홈페이지	www.techwing.co.kr	
임직원수	537명('17)	591명('18.2Q)
매출액	2,227억('17)	890억('18.2Q)
소재지	본사: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 37 안성사업장: 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 아산사업장: 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 387번길 118	
제품 영역	반도체 IC Test Handler, Module Test Handler, Test Board, 공장 자동화(FA) 설비 등	
자회사	(주)이엔씨테크놀로지(디스플레이 제조/검사장비) 보유지분 56%	

주요 연혁

- 2002.07 (주)테크윙 설립
- 2004.04 벤처기업 인증
- 2004.08 ISO 9001, 14001 획득
- 2004.09 CE 마크 획득
- 2005.08 기업부설연구소 설립 인증
- 2010.07 제2공장 안성사업장 오픈
- 2010.11 OHSAS 18001 획득, 대표이사 산업포장 수상
- 2010.12 지식재산 경영 우수상 수상
- 2011.11 코스닥시장 상장, 제1회 전자IT산업 특허경영상 수상
- 2011.12 5,000만불 수출탑 수상
- 2012.12 7,000만불 수출탑 수상
- 2013.03 모범납세자 표창 수상
- 2014.01 Test Handler 누적출하 1,000대 달성
- 2016.05 샌디스크 2015년 최우수협력사'로 선정
- 2016.12 1억불 수출탑 수상
- 2017.12 2018년 청년친화강소기업 선정(고용노동부)
- 2018.01 아산사업장 신사옥 준공

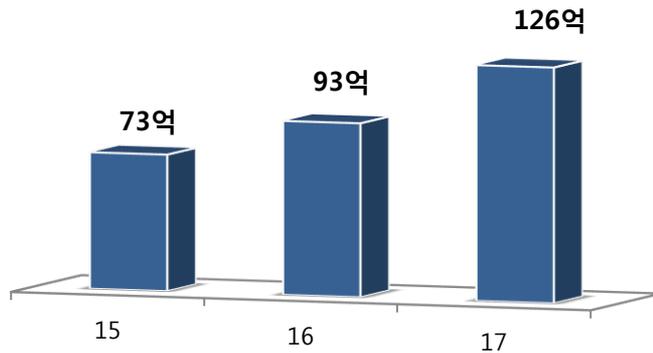
2. 회사 경쟁력



▶ 업계 최대규모의 R&D 조직 운영과 투자



▶ 인정 받은 품질, 서비스



3. 주요 고객사



구분	Memory Test Handler	Display 후공정 검사장비(자회사)
국내		
해외		

- 2018년 4Q 본격적인 중국 메모리 반도체 기업 낸드 양산 시작 예상, 이를 시작으로 향후 지속적인 중국시장 확대 기대
- 당사는 기존 메모리 반도체 부문에서 비메모리 및 모듈, SSD, 후공정 F.A 등 신규 Item 공급 확대 중. 따라서 더욱 다양한 신규 고객 확보 지속적으로 이어질 것

Chapter 2. 사업소개



1. 사업영역 : 반도체 전기적 검사공정 자동화 장비



“Memory Test Handler 전문기업에서 후공정 자동화 장비 기업으로 변화”

모듈/SSD검사공정 등에서 자동화 설비 투자 시작으로 공급 제품 다변화

후공정 중 전기적 검사공정 관련 자동화 장비로 제품 라인업 확대

구분	EDS (Wafer Test)	Burn-in Test	Final Test (IC Test)	Module/SSD Test
공정설명	[Electrical Die Sorting] 웨이퍼 완성 단계에 있는 개별 칩의 전기적 동작여부를 검사하는 공정	장시간 가동시 발생하는 열적 조건을 조성, 각각 Cell의 동작여부를 검사하는 공정	번인테스트 후 최종적으로 전기적 동작여부를 검사하는 공정	후공정을 마친 후 모듈 및 SSD 완성 과정에서의 기능 및 실장 상태를 검사하는 공정
주검사장비	(Wafer) Tester	(Burn-in) Tester	DC Tester	Module/SSD Tester
자동화장비 (테크윙)	Probe station * 2019년 시장 진입 목표	Burn-in Sorter * 2019년 시장진입 목표	Test Handler * 현재 주력제품	Test Handler + FA * 공장자동화 확대 수혜

※ 상기 제품 외에도 반도체 후공정 등 자동화(FA) 관련한 다양한 Item으로 제품 Line-up 확대 중

2. 주력제품 'Test Handler' 소개



“테스터의 검사결과에 따라 등급별로 분류하는 후공정 검사장비”

Wafer제조 → FAB공정 → 패키징 공정의 3단계 반도체 공정중 패키징공정 Final Test단계 검사장비로 활용

테스트 핸들러

- 양품과 불량품을 등급에 따라 자동 분류
- 검사를 위한 적절한 온도와 환경 조성
- 전기적 시험공정에서 반도체 칩을 주검사 장비로 공급

Interface board



▪ 핸들러와 테스터 접속연결 보드

Change over kit



- 핸들러 내 검사환경 조성 Kit
- 다른 종류의 Device 검사시 교체수요 발생

테스터

- 컴포넌트, 모듈, 실장 등 검사장비
- TechWing 사업영역 외 제품.

■ 테크윙 ITEM

■ 테크윙 사업영역 외

3. 주요 제품 포트폴리오



As of 2017, our product line-up includes various FA equipment

Chip level test handler

- Memory test handler
- Non-memory test handler
 - dual temp handler
 - tri temp handler



Module & SSD test handler

- **Module handler**
 - System level testing solution
 - Panel level testing solution
- **SSD test handler**
 - Standalone & Inline testing solution

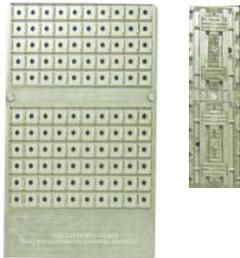


Others(New Products)

- SLT Handler
- Strip Handler
- TAB Handler
- AGV(Automatic Guided Vehicle)



Accessories



Change over kit

- Construct different environments for different devices
- Different devices require different COK



Interface board

- (Load board or DSA board)
- Connection Board between the handler and tester

• Also provide Parts, and Tester Heads to clients

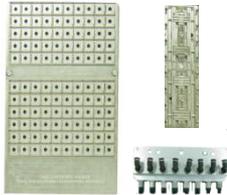
4. 반도체 부품 및 주변장치



“장비관련 부품과 주변장치 공급 확대로 안정적 매출 및 고부가가치 창출”

- C.O.K(Change over kit)교체수요 지속적 발생
- Interface board (Tester와 Handler 사이에서 전기적 신호를 연결해주는 장치) 고객 확대
- Handler Install Base 증가에 따른 Parts 매출 증가

핵심부품 및 주변장치



Change over kit

- 핸들러내 검사환경 조성 역할, 다른 종류의 디바이스 검사시 교체

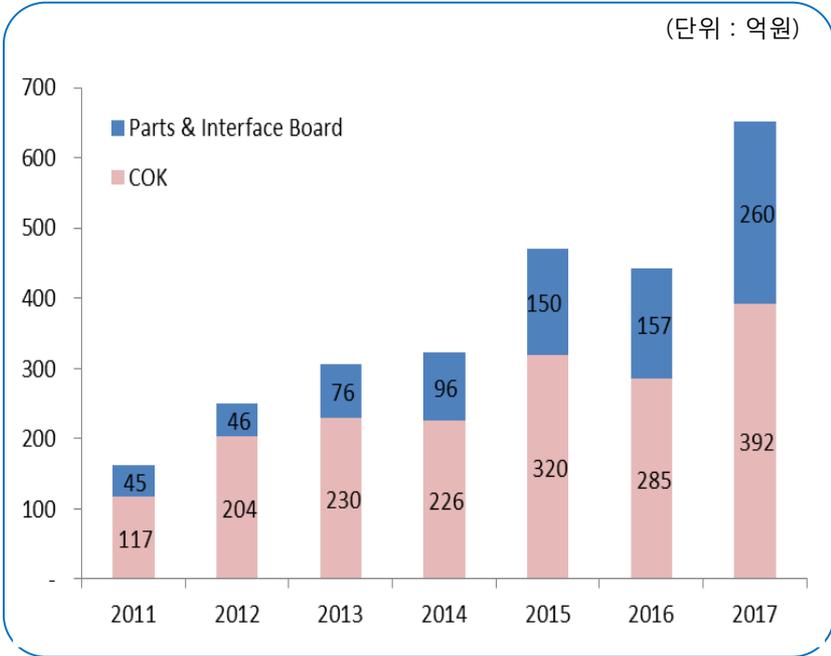
Interface board

- 핸들러와 테스터 접속 연결 보드

*** 2015년 본격적인 양산 공급**

※ 기타 Parts : 장비내 소모성 기타 부품류 별도

부품 및 주변장치 매출 추이



5. 디스플레이 외관검사장비 : 이엔씨테크놀로지



“디스플레이 후공정 외관검사장비 분야 - Inspection 장비 개발 선두주자로 성장 목표”

- 2017년 신규 외관검사장비 대규모 공급 시작 → 외형확대 및 이익증가
- 연구소 및 QA용 프로젝트성 장비 공급 → 대규모 양산 공급 시작(검사공정 자동화에 따른 신규 개발 및 양산 공급)
- Manual 공정(인력 투입 검사)의 자동화(검사장비 도입)에 따른 신규외관검사장비 개발 공급 중

기업 개요

회사명	주식회사 이엔씨테크놀로지(대표이사 이동구)
설립일	1999년 10월 5일(비상장/중소/벤처기업)
테크윙 지분율	56%
임직원수	70명(2017년 12월말 기준)
본사	경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 47
제품 영역	<ul style="list-style-type: none"> • OLED/LCD 후공정평가/생산장비 • OLED/LCD 검사장비(SVI) • Display/반도체 FURNACE/RTA설비

Item 다변화를 통한 매출 확대

제품

- 1) OLED/LCD Optical Evaluation (FPMS,BLU,LTS,IVL): : QA, 개발용
 - 광학측정장비
 - 디스플레이검사장비
- 2) Aging / Inspection Systems
 - : 수명/검사
- 3) Evaluation System (MTP / GTS)
 - : 화질조명장비
- 4) 모듈 외관검사장비(신규)
 - : 2017년 신규 대규모 공급 제품

최근 실적 및 전망

2016년

- 매출액 : 8,681 백만원
- 영업이익 : 152 백만원

2017년 매출액 : 356억
영업이익 40억

사업구조의 안정화 및 본격 성장 시작



6. 중장기 성장전략

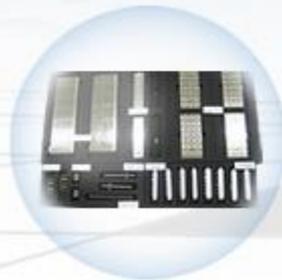


Test Handler 고객사를 적극 공략하여 공급 제품 확대! 공장자동화 제품군 다변화!

- Memory Test Handler 독점적 지위 유지
- SoC Test Handler 점유율 확대
- Module, SSD Handler 공급 확대
- Probe station, Burn-in Sorter 시장 진입
- 반도체 후공정 FA(공장자동화) 설비 확대
- 자동화 설비 타산업으로의 응용 적용



Chapter 3. Financial Highlight



1. Stock Information



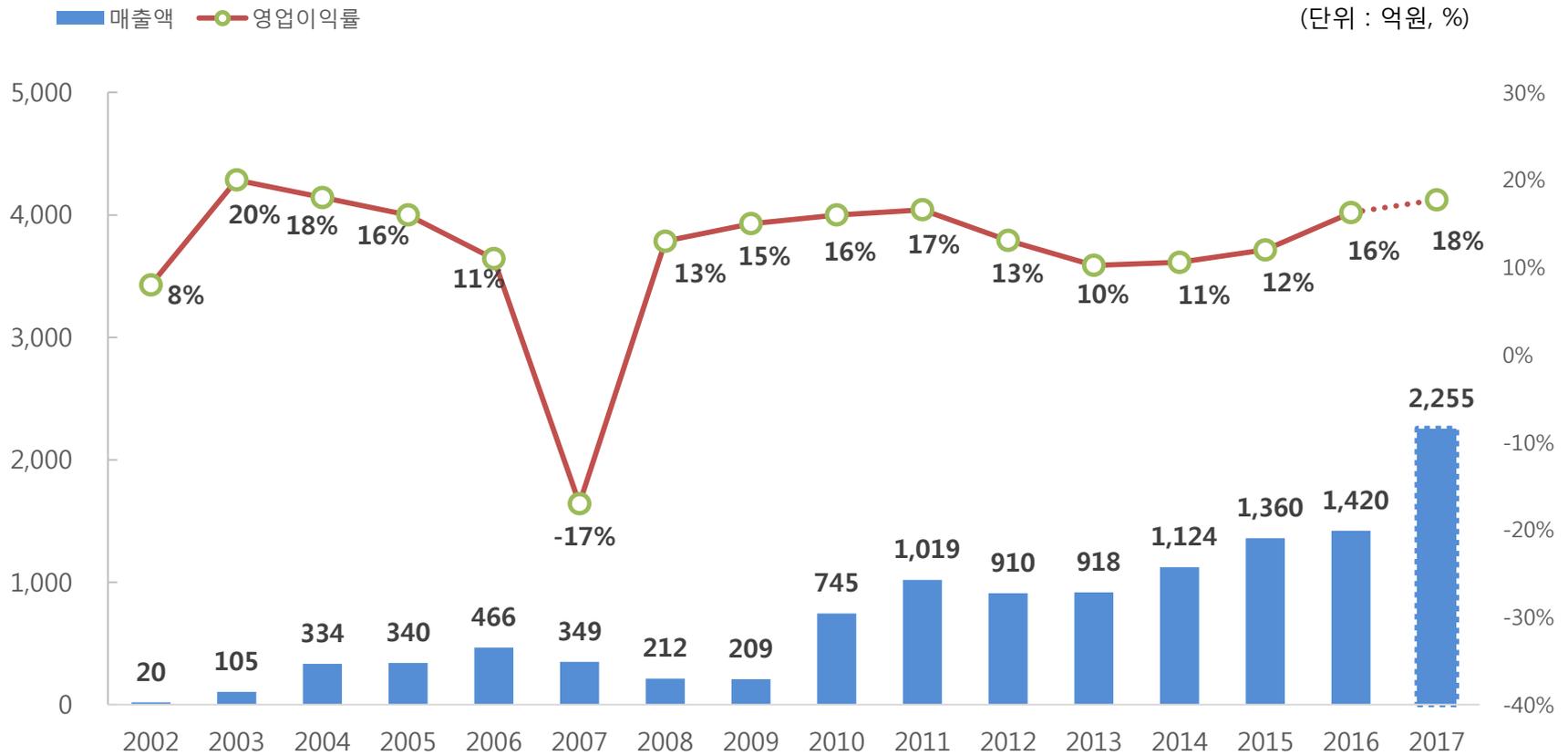
“테크윙은 지속성장을 통하여 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치와 최고의 만족을 제공할 수 있도록 노력을 지속하겠습니다.”

	Shareholders	Shares	(%)
A	최대주주 및 특수관계인	4,146,565	22.02%
B	가치투자자문	1,980,510	10.52%
C	미래에셋자산운용	1,524,922	8.10%
D	신영자산운용	1,569,926	8.34%
E	자사주	656,661	3.49%
F	기타	8,949,148	47.53
Total		18,827,732	100.0%

총 주식수 18,827,732주
(자사주 656,551주)
자본금 9,477,583,000원

- 가치투자자문 2018.11.08, 미래에셋자산운용 2018.08.01, 신영 자산운용 2018.09.28자 '주식등의대량보유상황보고서'에 의해 작성하였으며
- 자사주는 2018.10.24에 공시된 '신탁계약에의한취득상황보고서'를 근거로 당사가 최근일까지 취득한 자사주를 작성하였습니다.
- 2018.10.26 기준 외국인 보유지분율은 10.20% 입니다.

2. 연도별 실적



3. 2018.3Q 손익 실적(연결기준 실적)



3분기 매출액 YoY 5.7%(증가), 영업이익 YoY(-32.8%) 감소

(단위 : 백만원,연결기준)

구분	2018.3Q	2018. 3Q 누계	2017.3Q	2017. 3Q 누계	3Q YoY		3Q 누계 YoY	
					증감액	증감율	증감액	증감율
매출액	52,314	141,324	74,016	150,141	-21,702	-29.3%	-8,817	-5.8%
매출총이익	18,444	48,959	26,101	53,781	-7,657	-29.3%	-4,822	-8.9%
영업이익	8,445	20,274	16,851	29,216	-8,406	-49.9%	-8,942	-30.6%
세전이익	8,248	20,482	14,776	32,606	-6,528	-44.2%	-12,124	-37.1%
지배지분 귀속 당기순이익	8,676	19,440	13,003	29,835	-4,327	-33.3%	-10,395	-34.8%
매출총이익율(%)	35.2%	34.6%	35.2%	35.8%	연결자회사 실적감소 영향 및 환율 하락			
영업이익율(%)	16.1%	14.3%	22.7%	19.5%	연결자회사 실적감소 영향 및 환율 하락, 고정비 증가			
지배지분 귀속 당기순이익율(%)	16.5%	13.7%	17.5%	19.8%	-			

4. 최근 3개년 요약 연결재무제표



Summary of Consolidated Balance Sheet

(Unit : KRW mm)

As of 31 December	2017	2016	2015
Current Asset	175,708	105,333	92,679
Non-current Asset	166,671	162,311	118,888
Total assets	342,380	267,645	211,567
Current Liabilities	150,247	84,210	71,467
Non-current Liabilities	39,506	76,020	43,437
Total Liabilities	189,753	160,230	114,904
Capital Stock	9,264	9,106	8,703
Capital Surplus	37,342	34,081	28,893
Other capital items	851	(2,705)	448
Retained Earnings	103,475	69,026	58,614
Non-controlling Interest	1,691	(2,094)	5
Total Stockholders' Equity	152,626	107,414	96,663

Summary of Consolidated Income Statement

(Unit : KRW mm)

For the year ended 31 December	2017	2016	2015
Sales	222,772	141,979	136,032
Cost of Sales	144,538	90,464	90,543
Gross Profit	78,234	51,515	45,489
Operating Profit	41,516	23,093	23,278
Profit before Tax	47,993	18,103	21,401
Income Tax	8,606	3,460	4,696
Net Income	39,387	14,643	16,705